

(株)FJコンポジット様見学会 & 先端半導体セミナー

開催日時 2025年12月15日（月） 10：00～17：00

場所 見学会：(株)FJコンポジット様

<https://www.fj-composite.com/>

セミナー：千歳アルカディアプラザ

<https://www.plaza-c.co.jp/>

主催 (一社) エレクトロニクス実装学会北海道・東北支部

協賛 (公財) 北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）

(一社) 溶接学会北海道支部



北海道千歳市へのRapidusの半導体工場建設に伴い北海道内には半導体関連産業の集積が進みつつあります。北海道・東北支部では、半導体用のヒートシンク、セラミック絶縁回路基板（DBC・S-DBD）、燃料電池用セパレータなどで、最先端分野向け素材を手がけている株式会社FJコンポジットの見学を企画いたしました。

1.FJコンポジット様見学会 10：00～11：50（先着30名まで）

2002年設立の複合材料ベンチャーで、金属・炭素（カーボン）・セラミックス・樹脂など異なる材料を組み合わせた電子材料を開発・製造しています。主力製品は半導体用のヒートシンク、セラミック絶縁回路基板（DBC・S-DBD）、燃料電池用セパレータなどで、最先端分野向け素材を手がけています。

2.セミナー「2nm世代先端半導体とその先の挑戦

ー 日本発の半導体技術開発と前後工程融合」

13：00～16：30（現地100名迄）

半導体や実装・パッケージングにおける最新トピックスについて、ラピダス(株)折井専務執行役員、モルガン・スタンレーMUFG証券 和田木マネージングディレクターに講演頂きます。あわせて東北大学日暮教授から接合技術の最前線について解説いただきます。

13：10-14:10

講演1：[半導体業界の明るい未来]

モルガン・スタンレーMUFG証券

マネージングディレクター

和田木 哲哉氏



14：25-15：25

講演2：[異種材料集積に向けた接合技術の動向と展望]

東北大学大学院工学研究科 電子工学専攻 教授

エレクトロニクス実装学会会長

日暮 栄治先生



15：45-16：45

講演3：[メイド・イン・ジャパンの挑戦：チップレット技術が拓く新次元への道]

Rapidus（株）

専務執行役員 エンジニアリングセンター長 折井 靖光氏



3.交流会

* 講師を囲んで、今後の最新半導体パッケージのついて、意見を交換する場として
儲けました。是非千歳の地で、講師、参加者、実装学会関係者で、意見交換を
いたしましょう。**17時00分より交流会を開催します。**

4.参加費

◎ FJコンポジット様見学会＋セミナー

- ・会員／賛助会員／協賛学会会員10,000円
シニア会員5,000円、非会員14,000円
学生会員1,000円、一般学生2,000円
(いずれも税込、交流会費込)

<<参加登録は以下からお願いします。>>

会 員

賛助会員

協賛会員

非会員

下記参加資格よりお申込みください。

交流会参加ご希望の方は、申し込みの際に【**交流会参加**】を選択ください。

* シニア会員、学生会員は会員から、一般学生は、非会員から登録ください。

【申込締切： 2025年12月5日（金）】

* 注意事項 *

- ・請求書、領収書の発行：
申込登録完了メールのマイページURL⇒ログイン⇒決済
⇒出力
- ・支払方法：カード決済、コンビニ決済…手数料なし（学会負担）
 - * 正会員は専用口座への振込み可能
(非会員の方は、振込み対応ができません。)
 - クレジットカード決済をお願いいたします。**



こちらから申し込みください。